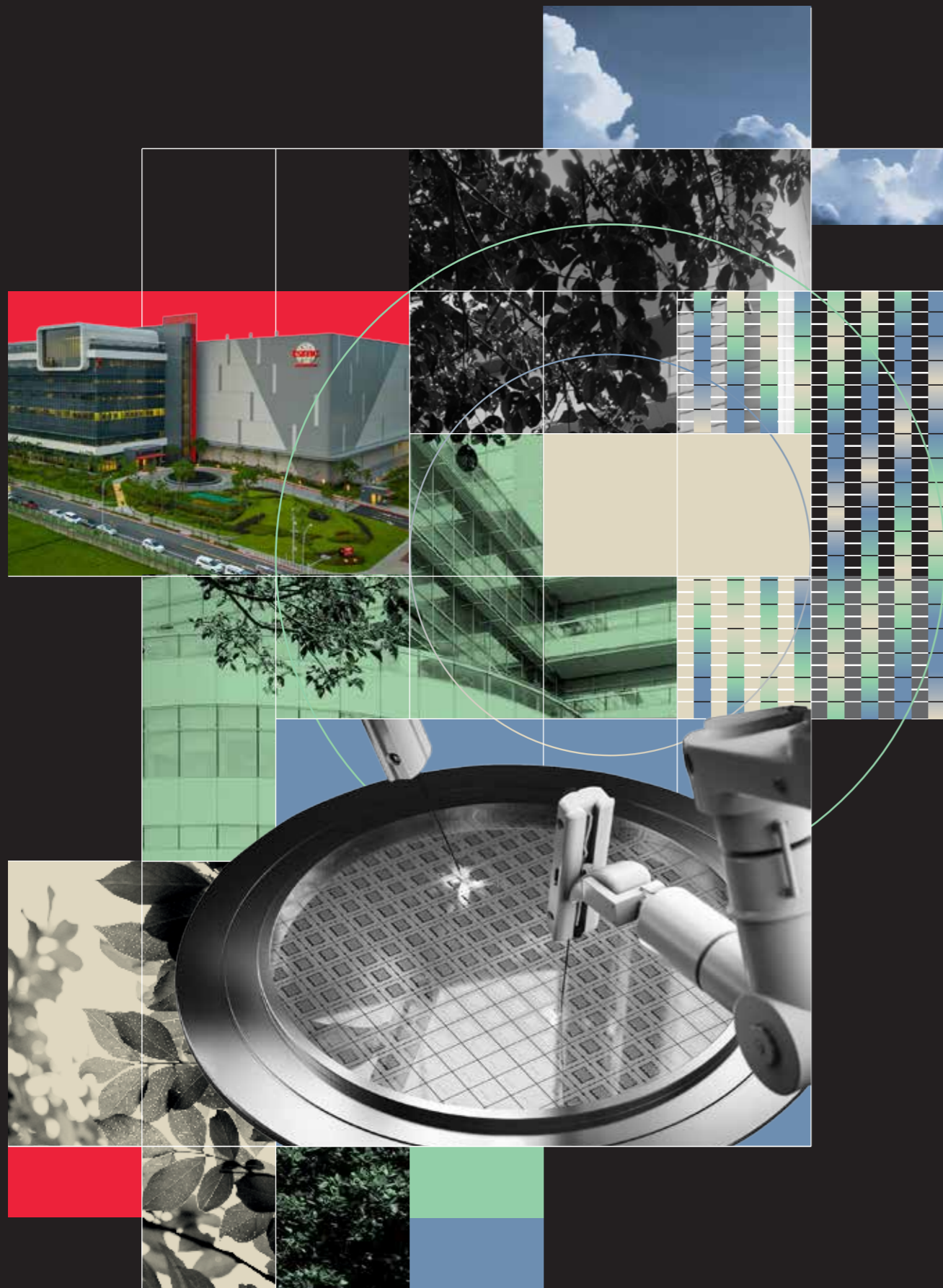


1



致股東報告書

台積公司使命

作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者

各位股東女士、先生：

民國一百一十三年對台積公司而言是傑出的一年。在我們領先的技術和廣泛的客戶群支持下，我們觀察到市場對人工智慧（AI）相關的需求在全年間都非常旺盛。然而，由於總體經濟疲軟持續影響消費者信心，在其他應用方面則僅有微幅復甦。在市場對我們先進邏輯製程與先進封裝技術有強勁需求的情況下，若以美元計，台積公司營收年增30%，成長幅度遠超過晶圓製造產業6%的增長，並且營收和每股盈餘均創下歷史新高。

台積公司持續對研發和技術發展進行投資以支持客戶的成長。在我們3奈米製程技術邁入量產的第二年，受到智慧型手機和高效能運算（HPC）應用的推動，市場對我們領先業界的3奈米製程技術需求依然強勁，占台積公司民國一百一十三年整體晶圓銷售金額的18%。

台積公司的2奈米製程技術在滿足客戶對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的IC創新者都正在與台積公司合作。我們的N2製程技術預計在民國一百一十四年下半年進入量產；我們也推出了A16解決方案，這項製程技術採用創新的、業界最佳的晶圓背面供電網路解決方案，最適用於HPC產品。A16製程技術計畫於民國一百一十五年下半年進入量產。

我們也正在開發先進封裝和3D晶片堆疊技術，包括CoWoS®、整合型扇出（Integrated Fan-Out, InFO）、TSMC-SoIC®（系統整合晶片）和矽光子（Silicon Photonics），在可負擔的成本下實現更低功耗的大規模互連，以支持客戶需求。

在成熟製程技術方面，我們與策略性客戶緊密合作，開發滿足其特定需求的特殊製程技術解決方案；這些夥伴關係使我們能夠創造技術差異化，並為客戶提供持久的價值。

我們相信台積公司的N3、N2、A16及其衍生技術、特殊製程技術以及先進封裝和晶片堆疊解決方案，將進一步擴大我們的技術領先地位，並讓台積公司得以掌握未來成長的機會。

我們的客戶期待台積公司不僅提供最先進的技術，還能提供最高效和最具成本效益的大規模製造服務。為了因應長期市場需求的結構性成長，台積公司正與客戶緊密合作以規劃我們的產能，並投資於先進製程、特殊製程和先進封裝技術，以支持客戶的需求。

我們採用嚴謹而周密的產能規劃系統，來評估和判斷長期市場需求的結構性成長，以決定適當的產能建置。

同時，我們致力於獲取可持續且穩健的報酬，使我們能夠繼續進行投資以支持客戶的成長，並為股東創造盈利增長。

這項策略的其中一部分包括根據客戶對地緣彈性的需求以及一定程度的政府支持來擴展我們的全球製造版圖。如此將使台積公司股東價值最大化。

民國一百一十三年，我們在海外擴展方面取得了重大進展。在美國亞利桑那州，我們的第一座晶圓廠早於原定計畫，在民國一百一十三年第四季採用N4製程技術進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。憑藉我們的製造能力和執行力，我們有信心提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

在日本，我們位於熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠於民國一百一十三年底以非常好的良率開始量產。在歐洲，我們於八月在德國德勒斯登舉行了動土典禮，計畫建設一座以汽車和工業應用為主的特殊製程技術晶圓廠，該項目的進展順利。

在台灣，我們持續在多個地點進行投資並擴大包括3奈米、2奈米和CoWoS®技術在內的先進製程技術和封裝產能。

作為全球最可靠、最有效的產能提供者，台積公司將持續在全球半導體產業中扮演著關鍵且不可或缺的角色，並為我們客戶的成長提供支持。

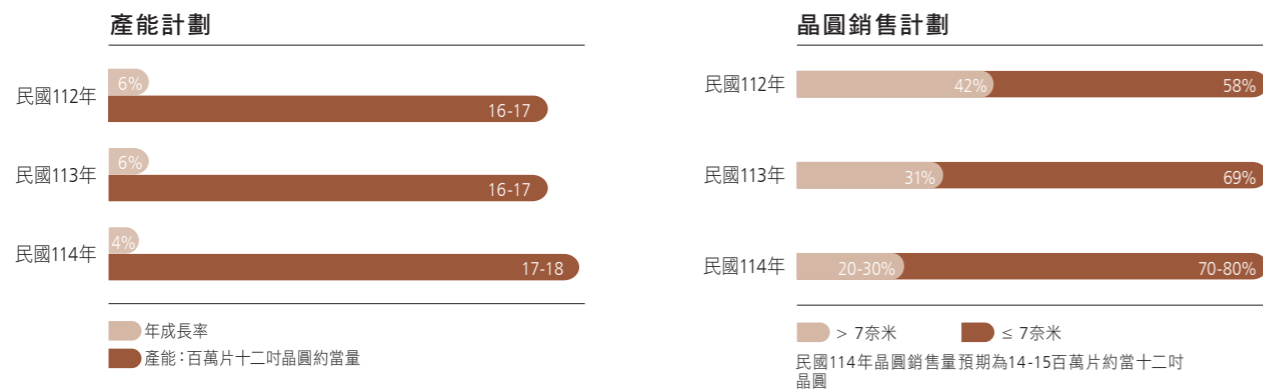
台積公司民國一百一十三年主要成就包括：

- 晶圓出貨量達1,290萬片十二吋晶圓約當量，民國一百一十二年為1,200萬片十二吋晶圓約當量。
- 先進製程技術（7奈米及以下先進製程）的銷售金額占整體晶圓銷售金額的69%，高於民國一百一十二年的58%。
- 提供288種不同的製程技術，為522個客戶生產1萬1,878種不同產品。
- 台積公司占晶圓製造2.0產業產值的34%（我們將晶圓製造2.0產業定義為所有邏輯晶圓製造、封裝、測試、光罩製作與其他），民國一百一十二年為28%。

財務表現

台積公司民國一百一十三年全年合併營收為新台幣2兆8,943億1,000萬元，較前一年的2兆1,617億4,000萬元增加33.9%；稅後淨利為新台幣1兆1,732億7,000萬元，每股盈餘為新台幣45.25元，較前一年稅後淨利新台幣8,385億元及每股盈餘32.34元均增加了39.9%。

若以美元計算，台積公司民國一百一十三年全年合併營收為900億8,000萬美元，稅後淨利為365億2,000萬美元，較前一年度的全年合併營收693億美元增加了30%，較前一年度的稅後淨利268億8,000萬美元增加了35.9%。



台積公司民國一百一十三年毛利率為56.1%，前一年為54.4%；營業利率為45.7%，前一年則為42.6%。稅後純益率為40.5%，較前一年稅後純益率38.8%增加了1.7個百分點。

台積公司民國一百一十三年現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣11.25元提高至每股新台幣14.0元。

未來展望

進入民國一百一十四年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期整體晶圓製造產業將維持溫和復甦；同時，我們預計民國一百一十四年對於台積公司又會是穩健成長的一年，我們的技術領先使台積公司贏得業務，並進一步使我們的客戶能夠在其終端市場上取得成功。

民國一百一十四年，與AI相關的持續需求支持著我們本就堅定的信念，即隨著我們周遭的一切事物變得更加智慧與互連，對節能運算的結構性需求將加速成長。

我們正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦（PC）、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。

AI也會有許多不同的形式，包括但不限於生成式AI應用；例如ChatGPT便由於其易於使用和廣泛的潛在應用範圍，消費者已逐漸熟悉此類應用。

企業是AI需求的另一個驅動力，包括台積公司在內的許多企業都正在使用AI來提高生產力、效率、速度和品質效益，以創造更多價值。作為在我們的晶圓廠和研發營運中直接運用AI的公司，我們正從對AI和機器學習的投資中收穫實際的投資報酬利益，台積公司絕對不是世界上唯一這麼做的公司，因此，企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源。

AI技術正在不斷發展，所使用的AI模型也越趨複雜，這需要更強大的半導體硬體支援。

也正因如此，我們技術平台的價值正在增加，因為客戶仰賴台積公司以最高效和最具成本效益的方式，大規模地提供最先進的製程和封裝技術。

透過秉持技術領先、卓越製造和客戶信任的三位一體優勢，我們可以打造一廣泛的網絡來與所有IC創新者共同合作，使我們的客戶能在他們的終端市場釋放創新。

因此，我們身處在極佳位置，能以差異化技術應對5G、AI和HPC等產業大趨勢的成長。

台積公司的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。我們的成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，而我們的任務便是為客戶提供服務，幫助他們取得成功。

作為全球最可靠且最有效的產能提供者，我們深刻體認到我們在全球半導體產業中所扮演的角色以及必須承擔的相應責任。我們將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，並確保我們的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

台積公司秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值，使我們贏得了客戶的信心，與我們共同成長與茁壯。我們希望未來透過繼續實現獲利成長並最大化股東價值，從而贏得股東同等的信心。



魏哲家

魏哲家
董事長暨總裁

台積公司財務、營運與永續成就

財務績效

合併營收新台幣
2兆8,943億1,000萬元
 較前一年增加**33.9%**，創歷史新高

毛利率
56.1%



每股盈餘
45.25元
 創歷史新高

現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣**11.25元**提高至每股新台幣**14.0元**

稅後淨利為新台幣
1兆1,732億7,000萬元
 較前一年增加了**39.9%**

永續成果

供應商**減碳績效**
 列入選商指標
 加速供應鏈去碳化

台中零廢製造中心為
 全台第**1**個導入薄膜
 捕捉技術示範場域



補助供應鏈減碳
 帶動綠色投資
新台幣55億元

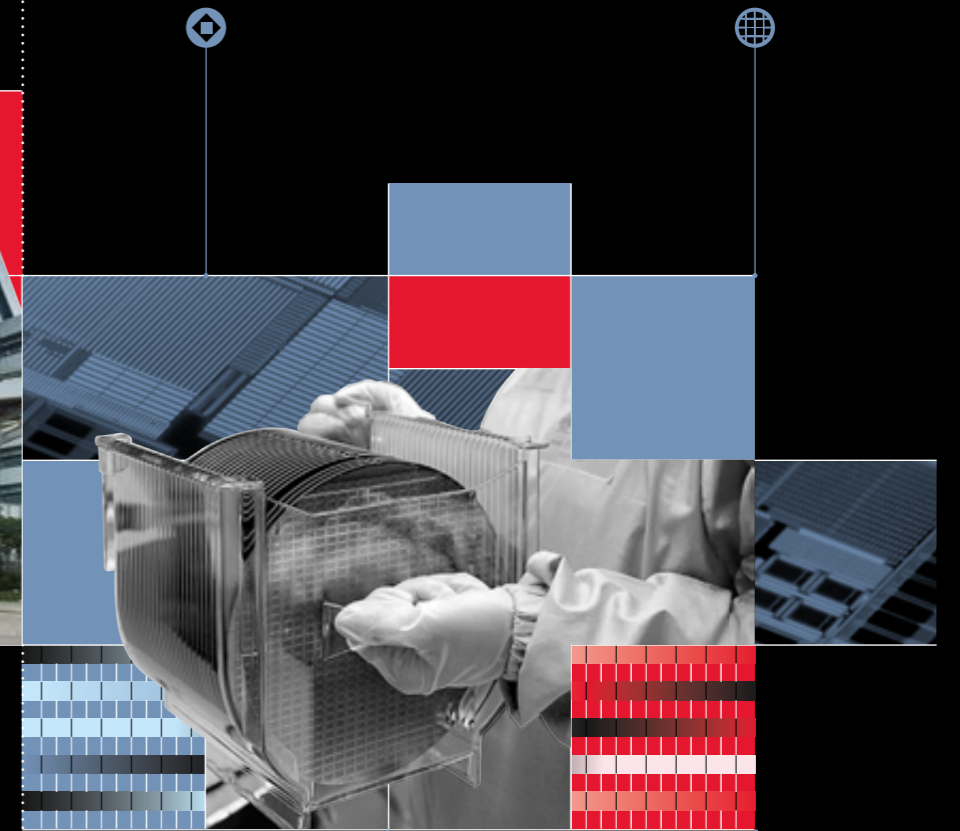
2050年實現
淨零排放

獲選道瓊永續世界指數的組成企業
 是全球唯一
 連續**24**年入選
 的半導體公司

營運成就

先進製程技術（7奈米及
 以下先進製程）的銷售金
 額占整體晶圓銷售金額的
69%

台積公司晶圓出貨量達
1,290萬片
 十二吋晶圓約當量



提供**288**種不同的製程
 技術，為**522**個客戶生
 產**11,878**種不同產品

台積公司佔晶圓製
 造2.0th產業產值的
34%

研發費用達
63億6,100萬美元

註：晶圓製造2.0中包含了封裝、測試、光罩製作與其他，以及所有除了記憶體製造之外的整合元件製造商。